# 苏州盛科通信股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大溃漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议, 落实以投资者为本的理念,推动苏州盛科通信股份有限公司(以下简称"盛科通 信"或"公司")持续优化经营、规范治理和积极回报投资者,大力提高上市公 司质量,助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求,结合公司 自身发展战略、经营情况和财务情况,特制定盛科通信 2024 年度"提质增效重 回报"行动方案,以讲一步提升公司经营管理水平,强化市场竞争力,提升资本 市场参与者的信心,稳定股价,树立良好的资本市场形象。主要措施如下:

## 一、持续加大研发投入,坚持技术创新,引领公司高质量发展

盛科通信为国内领先的以太网交换芯片设计企业,以太网交换芯片是构建企 业网络、运营商网络、数据中心网络和工业网络的核心平台型芯片。经过十余年 的技术积累,公司现已形成丰富的以太网交换芯片产品序列,公司在国内具备先 发优势和市场引领地位,产品覆盖从接入层到核心层的以太网交换产品,为我国 数字化网络建设提供了丰富的芯片解决方案。

公司面向国家数字化网络建设需求,以打造更快、更灵活、更安全、更智能

的网络为目标,坚持自主研发。基于规模化市场应用的反馈、对产业链的理解和影响以及行业标准组织的深度参与,公司芯片产品完成数次迭代,现已形成高性能交换架构、高性能端口设计、多特性流水线等 11 项核心技术,构建了具备自主知识产权、具备国内领先地位、符合本土化需求的核心技术能力,建立了完善的设计、工艺、测试平台。

持续高水平的研发投入是公司保持核心竞争力的关键因素。为实现战略目标,致力公司长远发展,公司维持较高的研发费用率进行技术积累和产品创新,持续提高产品丰富度及性能功能指标,以保持产品与技术的快速迭代和竞争优势。2023年度,公司持续加大研发投入强度,全年研发费用31,411.19万元,较上年同期增长19.00%,占营业收入比重为30.28%。截至2023年年末,公司研发人员总数371人,较上年末增加30人,研发人员占公司总人数的比例为74.65%。

2024年度,公司以进一步加大研发投入保持市场竞争优势为中心,尤其是 关键核心领域的研发投入和技术创新,为公司长期发展提供强劲动能。在高端产 品方面,明确对高端领域产品加大投入的决心,在新兴应用对超大规模数据中心 及其接入网络建设需求的刺激下,积极布局相关产品、加大研发投入,力争在快 速发展的新兴市场中形成较强的核心竞争力。在中端和低端产品方面,公司将结 合下游客户对公司产品的需求,积极推进当前产品系列裂变的延展扩充或迭代升 级,持续优化既有产品性能,加快提升公司产品的丰富度,把握住当下国产化的 发展契机,提升公司在相关市场的市场份额、巩固市场地位,不断提高公司产品 的综合竞争力,保障公司可持续发展和高质量发展。

公司目前产品主要定位中高端产品线,产品覆盖 100Gbps~2.4Tbps 交换容量及 100M~400G 的端口速率,全面覆盖企业网络、运营商网络、数据中心网络和

工业网络等应用领域。其中, TsingMa.MX 系列交换容量达到 2.4Tbps, 支持 400G 端口速率, 支持新一代网络通信技术的承载特性和数据中心特性; GoldenGate 系列芯片交换容量达到 1.2Tbps, 支持 100G 端口速率, 支持可视化和无损网络特性; TsingMa 系列芯片集成高性能 CPU, 为企业提供安全、可靠的网络, 并面向边缘计算提供可编程隧道、安全互联等特性。公司面向大规模数据中心和云服务的芯片产品已于 2023 年给客户送样测试, 2024 年预计实现小批量发货,该产品支持最大端口速率 800G,搭载增强安全互联、增强可视化和可编程等先进特性。

## 二、聚焦经营主业,以生态建设为引领,提升经营质量

盛科通信主营业务为以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售,以太 网交换芯片广泛应用于整个信息化产业。随着网络通信技术的不断更新迭代以及 云计算、物联网等技术的发展,网络的边界和能力将得到前所未有的拓展与提升, 其蓬勃发展将推动信息化产业进入全互联时代。当前网络体系面向不同应用领域 可划分为企业网络、运营商网络、数据中心网络和工业网络四个关键应用场景。 由于网络体系的每个关键应用场景均采用类似接入、汇聚和核心的组网架构,因 此均需要系列化的以太网交换芯片产品。

2023 年度,公司聚焦主业,持续丰富产品矩阵,不断优化以太网芯片产品的性能和质量,提高客户支持水平,扩展产品应用领域。在面临艰难的外部市场环境下,公司销售业绩在本年度依旧保持增长趋势,实现营业收入103,741.60万元,较上年同期增长35.17%。

2024年度,公司持续加大在产业生态建设方面的投入,通过提升对行业前 沿技术的探索力度以及持续积极的组织参与行业标准的建设,巩固公司在国内以 太网交换芯片行业市场地位,深化与直接客户、最终客户的合作关系,进一步打 造生态优势。借助前期初步构建的产业生态以及积累的优良口碑,公司将进一步推动市场开拓进展。一方面,公司将持续推进已处于量产阶段的产品销售,扩大在企业网络、运营商网络、中等规模数据中心网络及工业网络的客户持续深度合作,实现现有产品市场份额的突破;另一方面,公司将把握超大规模数据中心、云计算、边缘计算等新兴领域对高性能交换芯片的需求,凭借公司领先的技术优势,积极与新兴场景下的应用客户进行接洽与合作,推动新产品、新客户的导入,加速应用场景落地。

公司目前尚未盈利,但凭借深厚的技术积累,在精准把握客户需求的基础上加大研发力度、优化产品性能,近年来陆续推出了能够满足市场普遍需求的新产品,未来还将推出更全面的覆盖高端、中端、低端全领域的系列芯片产品。公司坚信,随着研发的芯片产品系列丰富度逐步加强,客户认可度不断提升,公司与主要客户的合作持续加深,芯片销量会呈现稳步增长趋势,公司产品销售盈利会得到改善和提升。在市场的大量应用下,公司的产品与技术已经得到了验证,构建了稳定的下游应用生态,在国产厂商中保持领先地位,为未来进一步的增长奠定了坚实的基础。2024年度,公司以进一步加大研发投入保持市场竞争优势为中心,预计 2024年度研发投入比 2023年度增长较大幅度,高强度的研发投入会为公司长期发展提供强劲动能,为公司未来实现盈利提供坚实保障。

#### 三、完善公司治理,提升规范运作水平

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性,将持续完善公司治理和内部控制制度,注重保护投资者,特别是中小投资者的合法权益。目前,公司通过不断完善治理结构,已经建立了由股东大会、董事会、监事会协调运作,规范有序的法人治理结构,公司董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会按照相应工作细则的规定,认真勤勉地履行各自职责。

公司给独立董事创造了便利的履职条件,切实保障了投资者特别是中小投资者的合法权益。公司董监高积极参与上交所等监管机构举办的各种培训,加强学习证券市场相关法律法规,熟悉证券市场知识,不断提升自律意识,推动公司持续规范运作。

2024年是公司上市后的第一个完整年度,公司将坚守信息披露和公司治理 双轮驱动,持续推进公众公司规范运作,积极承担企业社会责任,提升上市公司 治理水平。公司将继续加强规范重大信息内部报告工作,保证内部重大信息快速 传递、归集和有效管理,以确保公司信息披露真实、准确、完整、及时和公平。公司将不断健全内部治理体系及各项管理制度,提高重大事项的科学决策水平及 决策效率,优化资源配置,提高风险防范意识和抗风险能力,提升经营效率和精 细化管理水平。同时,公司将加强政策宣导和机制建设,强化"关键少数"的责任,对 5%以上大股东和公司董监高持股情况定期进行核查,不定期组织"关键 少数"培训学习不少于 5 次,不断提升规范运作意识。

#### 四、提高信息披露质量,加强投资者沟通交流

公司始终高度重视信息披露与投资者关系管理工作。2023 年,公司制定了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等制度,并根据上述制度依法履行信息披露义务,保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平,保障投资者的知情权,维护股东特别是社会公众股东的合法权益。公司积极通过投资者热线电话、公司公开邮箱、上证 e 互动、分析师会议、现场参观及业绩说明会等多种线上线下相结合的方式加强与投资者的联系与沟通,在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时,也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层,以积极应对市场变化、响应投资者诉求。公司于2023年9月14日上市,自上市以来,公司已通过上证 e 互动答复投资者提问61条,

并积极通过投资者热线电话与投资者沟通交流超过100次。

未来,公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作,通过公司官网、微信公众号等方式向广大投资者展示公司经营情况、研发情况、产品情况等;并继续做好内幕信息管理工作,切实维护好投资者获取信息的平等性。2024年,公司将开展至少3次业绩说明会,并通过各种形式切实保证投资者对公司信息的全方面了解,构建与投资者良好互动的生态,引导投资者更好地理解公司的投资价值。与此同时,公司将进一步优化投资者关系管理的工作机制和内容,丰富宣传途径和交流形式,探索构建多元化双向沟通渠道,实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。

### 五、积极践行 ESG 理念,助力可持续发展

公司重视 ESG 管理对企业的重要作用,积极履行社会责任、完善公司治理结构、兼顾保障股东、供应链、职工等相关各方利益,并开展与利益相关方广泛的沟通与合作,不断提升公司管理水平。公司始终以"用芯链接世界,创芯引领未来,造福人类数字生活"为发展使命、以"引领全互联时代网络芯片"为发展愿景,扎实做好技术研发的同时,践行环境、社会、治理责任,将可持续发展理念融入到公司运营的各个层面。

未来,公司持续在经营发展中将 ESG 融入企业文化、企业战略,承担企业社会责任,持续从健全治理制度、专注研发创新、提升员工凝聚力、重视投资者关系管理等维度不断提高自身的 ESG 的管理水平,保障公司可持续发展。

#### 六、持续评估完善行动方案,维护公司市场形象

公司将持续评估"质增效重回报"行动方案的具体举措,及时履行信息披露 义务。公司将继续专注主业,提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力, 通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者,切实履行上市公司责任 和义务,回报投资者信任,维护公司良好市场形象,促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司董事会 2024年7月15日